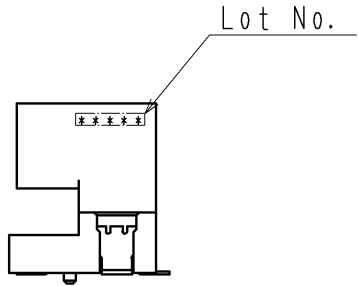
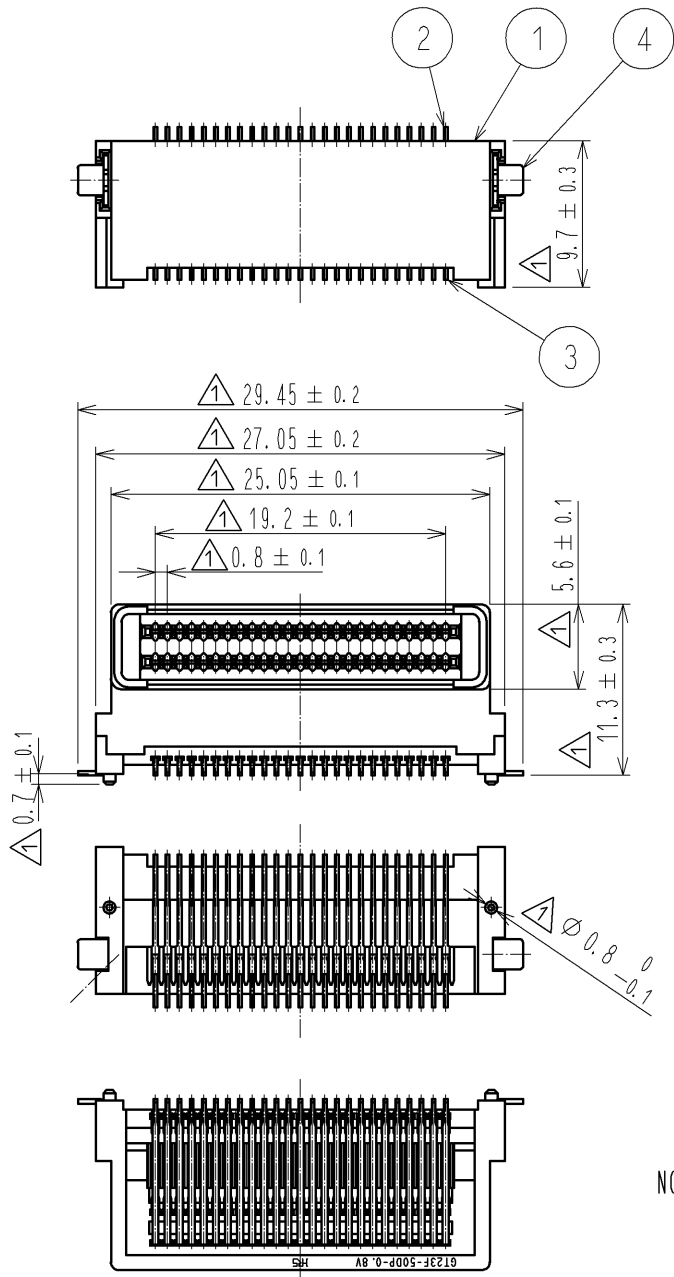


APPLICABLE STANDARD					
RATING	OPERATING TEMPERATURE RANGE	-40 °C TO +105 °C (NOTE1)		STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40 °C TO +105 °C
	VOLTAGE	50 V AC		CURRENT	0.5 A
SPECIFICATIONS					
ITEM		TEST METHOD		REQUIREMENTS	QT AT
CONSTRUCTION					
GENERAL EXAMINATION		VISUALLY AND BY MEASURING INSTRUMENT.		ACCORDING TO DRAWING.	X X
MARKING		CONFIRMED VISUALLY.			X X
ELECTRIC CHARACTERISTICS					
CONTACT RESISTANCE		0.5A DC.		100 mΩ MAX.	X -
CONTACT RESISTANCE MILLIVOLT LEVEL METHOD		20 mV AC MAX, 0.1 mA(DC OR 1000Hz)		100 mΩ MAX.	X -
INSULATION RESISTANCE		250 V DC		500 MΩ MIN.	X -
VOLTAGE PROOF		250 V AC FOR 1 min.		NO FLASHOVER OR BREAKDOWN.	X -
MECHANICAL CHARACTERISTICS					
MECHANICAL OPERATION		30 TIMES INSERTIONS AND EXTRACTIONS.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
VIBRATION		FREQUENCY 20 TO 400 Hz, 43.1 m/s ² AT 3 h FOR 3 DIRECTIONS.		① NO ELECTRICAL DISCONTINUITY OF 10 μs. ② CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
SHOCK		FREQUENCY 20 TO 50 Hz, 66.6 m/s ² AT 1 h.		① NO ELECTRICAL DISCONTINUITY OF 10 μs. ② CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
LOCK STRENGTH		APPLYING A PULL FORCE THE MATING AXIALLY AT -N MAX.		① DURING APPLYING, MATING COMPLETELY. ② AFTER APPLYING, NO DEFECT OF MATING PARTS.	- -
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS					
DAMP HEAT (STEADY STATE)		EXPOSED AT 60 °C, 90 ~ 95 %, 96 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
RAPID CHANGE OF TEMPERATURE		TEMPERATURE -40 → 5 TO 35 → 80 → 5 TO 35 °C TIME 30 → 5 → 30 → 5 min UNDER 1000 CYCLES.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
DRY HEAT		EXPOSED AT 105 °C, 300 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
COLD		EXPOSED AT -40 °C, 120 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
RESISTANCE TO HSO ³ GAS		EXPOSED IN 500 PPM FOR 8h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO HEAVY CORROSION.	X -
RESISTANCE TO SOLDERING HEAT		SOLDER TEMPERATURE, 260 °C FOR IMMERSION DURATION, 10 s.		NO DEFORMATION OF CASE OF EXCESSIVE LOOSENESS OF THE TERMINALS.	X -
SOLDERABILITY		SOLDERED AT SOLDER TEMPERATURE, 245 °C FOR IMMERSION DURATION, 3 s.		A NEW UNIFORM COATING OF SOLDER SHALL COVER A MINIMUM OF 95 % OF THE SURFACE BEING IMMersed.	X -
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
△0					
REMARK			APPROVED	AR. SHIRAI	10. 03. 29
(NOTE1) INCLUDE THE TEMPERATURE RISING BY CURRENT.			CHECKED	TY. TAKAHASHI	10. 03. 29
			DESIGNED	TY. SAKASHITA	10. 03. 29
			DRAWN	KT. MATSUDA	10. 03. 26
Note QT:Qualification Test AT:Assurance Test X:Applicable Test			DRAWING NO.		ELC4-167667-00
HRS		SPECIFICATION SHEET		PART NO.	GT23F-50DP-0. 8H
		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CODE NO.	CL773-0008-0-00 △0 1/1

ELV, RoHS COMPLIANT

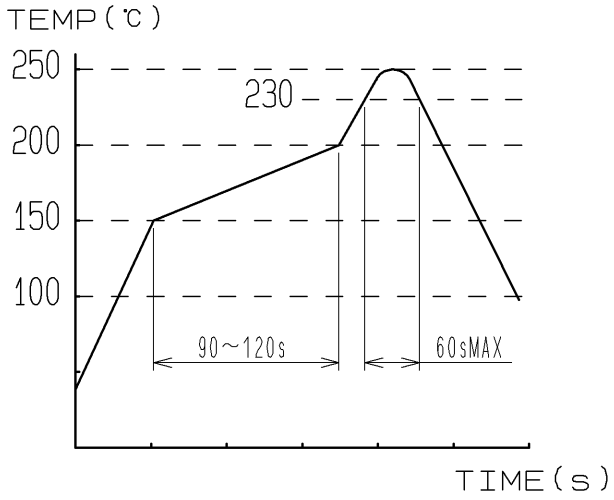


NOTE 1. CO-PLANARITY SHALL BE 0.1 MAX.
2. RECOMMENDED SOLDER THICKNESS=0.15

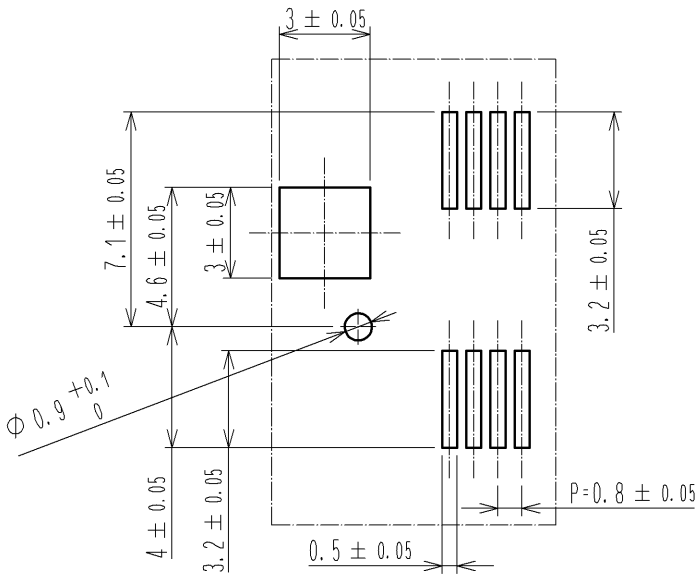
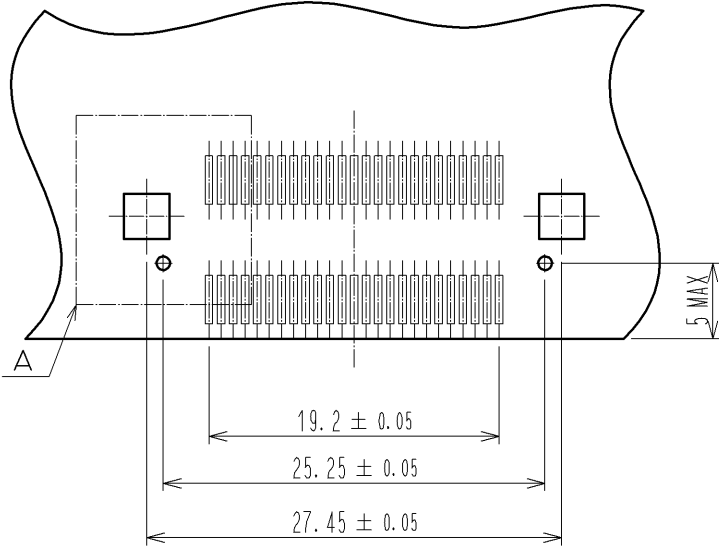
RECOMMENDED TEMPERATURE PROFILE FOR REFLOW

- 1. PEAK : 250°C
- 2. OVER230°C : 60sec MAX
- 3. PREHEAT : 150~200°C, 90~120sec
- 4. NO. OF CYCLES : 2 TIMES MAX

*This temperature profile is the recommended value. The temperature profile may differ depending on the cream solder, the manufacturer, the PC Board size, and other mounting materials, etc. Please confirm the mounting condition before applying the recommended temperature profile.



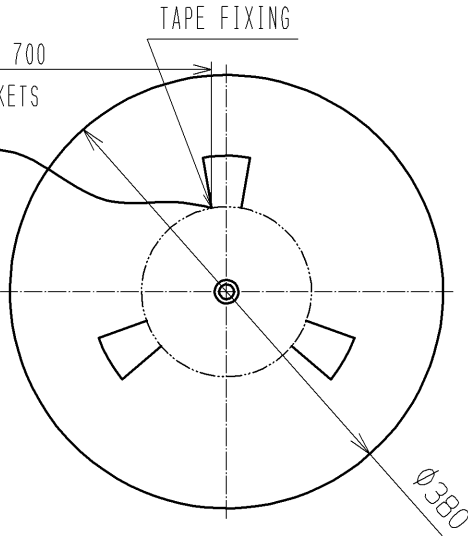
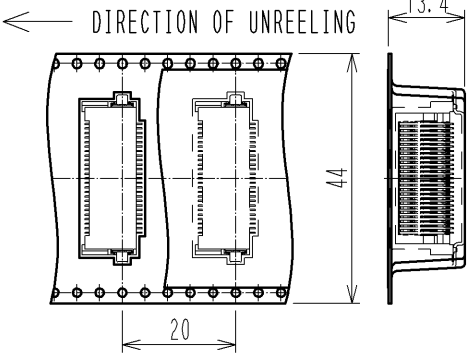
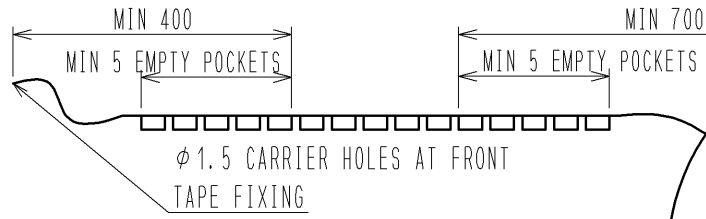
Recommended PCB layout



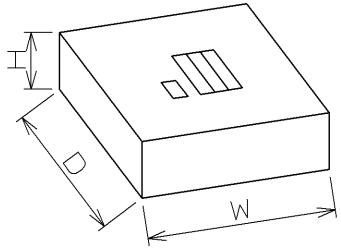
A(4:1)

PACKING STYLE

1. Place connectors into an embossed carrier tape.



2. Put a reel into a cardboard.



W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H=(49) (mm)

2	BRASS	Contact:GOLD PLATING. Mounting:TIN PLATING			4	BRASS	TIN PLATING				
1	PA	BLACK			3	BRASS	Contact:GOLD PLATING. Mounting:TIN PLATING				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				
UNITS mm				SCALE 2 : 1		COUNT 11	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-001896		DESIGNED HH. TSUKUMO	CHECKED TY. TAKAHASHI	DATE 10. 09. 30
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					APPROVED :AR. SHIRAI		10. 03. 29	DRAWING NO. EDC3-167667-00			
					CHECKED :TY. TAKAHASHI		10. 03. 29	PART NO. GT23F-50DP-0. 8H			
					DESIGNED :TY. SAKASHITA		10. 03. 29	CODE NO. CL773-0008-0-00			
					DRAWN :KT. MATSUDA		10. 03. 26	 			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru